EECO6A — Eletrônica A

Prof. Thales E. P. de Almeida

Física dos semicondutores

 Para compreender o funcionamento dos dispositivos eletrônicos semicondutores e suas características, é necessário abordar brevemente os princípios físicos que regem o funcionamento destes componentes

 Diodos, Transistores bipolares e transistores de efeito de campo, entre outros componentes, utilizam material semicondutor, geralmente o silício, para apresentar seu comportamento.

Física dos semicondutores

• Primeiramente vamos analisar o comportamento de uma estrutura cristalina de material semicondutor puro, ou **semicondutor intrínseco**

 Posteriormente analisaremos o processo de dopagem deste material e como isto afeta suas características de condução elétrica

 Finalmente analisaremos o comportamento de junções semicondutoras, dadas pela interface entre materiais com dopagens diferentes e como isto implica no comportamento atípico na condução de corrente elétrica

• O conceito de 'semicondutor' existe para definir materiais que não são bons condutores, como o cobre, ouro ou alumínio, mas que também não são materiais isolantes como o vidro, por exemplo.

Mas o que muda entre estes materiais?

- A quantidade de energia necessária para mover um elétron entre os átomos na estrutura que forma o material
- ➤ Teoria de bandas de energia

• Semicondutores são elementos que apresentam um potencial de barreira (...)

 Pesquisar e entregar junto ao relatório estas características dos elementos semicondutores, relacionados à teoria de bandas

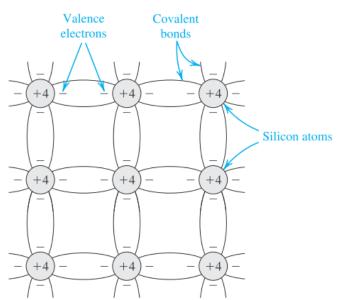
 Geralmente formados por um único elemento, como o Silício ou germânio, pertencente à família IV da tabela periódica, possuem 4 elétrons na camada de valência

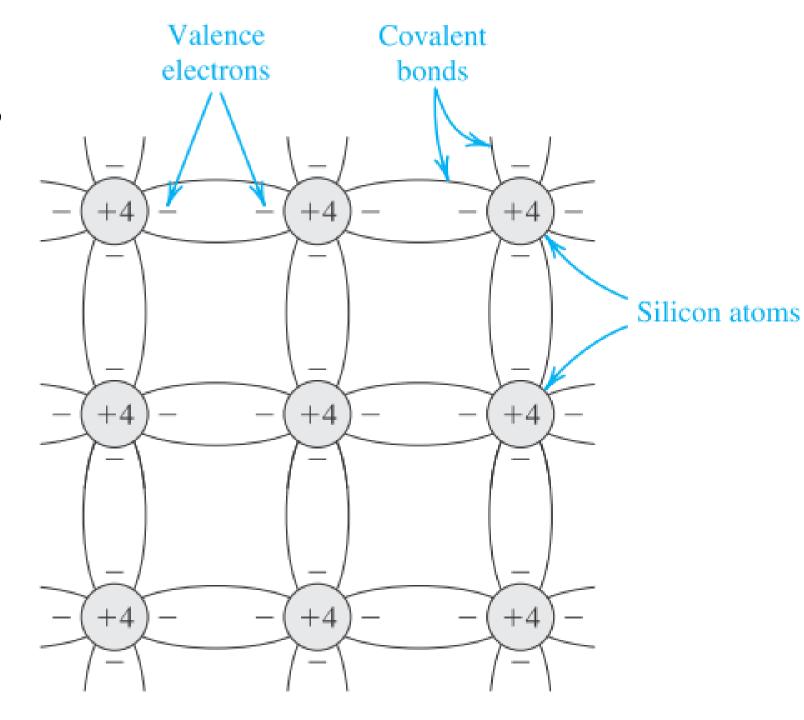
 Também podem ser compostos por pares de elementos, como Arsenieto de Gálio, combinando elementos das famílias 3 e 5, ou das famílias 2 e 6, geralmente utilizados em aplicações especiais como LEDs ou para altas frequências.

 Sabemos da física e da química que um átomo se comporta como eletronicamente estável quando possui 8 elétrons na camada de valência.

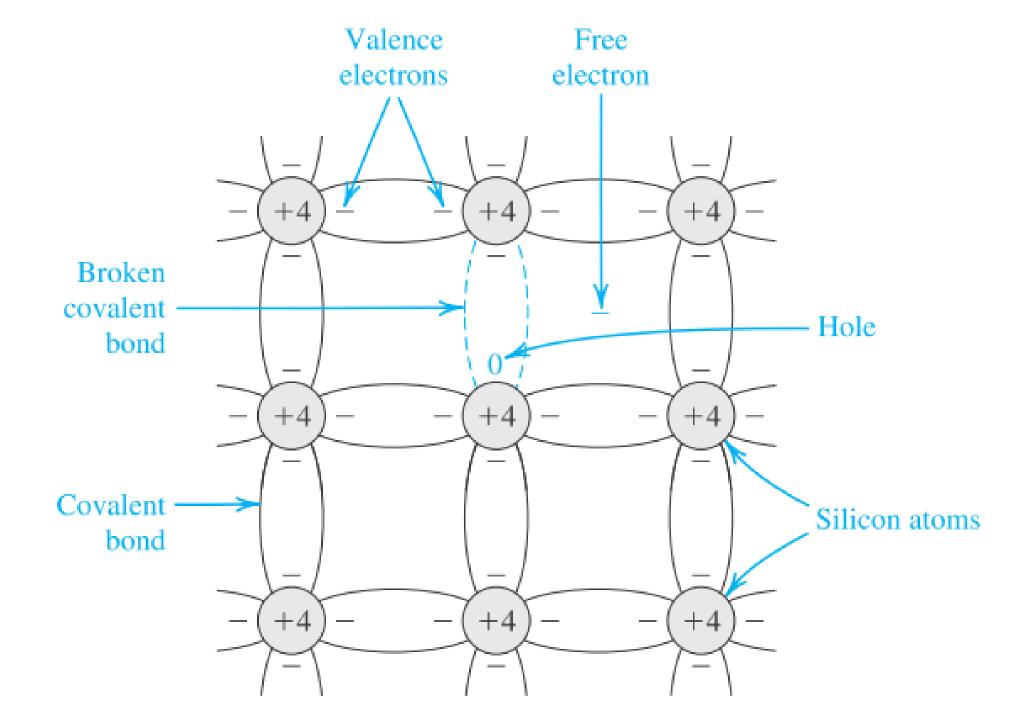
• O Silício forma um material cristalino compartilhando 4 elétrons em sua camada de valência por meio de ligações covalentes com os

átomos vizinhos





- Em temperaturas extremamente baixas, as ligações covalentes ficam intactas e não há elétrons livres para circular pelo material, desta forma o cristal de silício se comporta como um isolante.
- Com temperaturas maiores, como a temperatura ambiente, há energia térmica suficiente sendo entregue ao material de forma a romper algumas das ligações covalentes, 'liberando' elétrons
- Este elétron livre pode circular pelo material, portanto permitindo uma pequena corrente elétrica se estimulado por um campo elétrico



• Quando um elétron livre se desloca, seu átomo original passa a apresentar uma carga positiva, pois seu núcleo não foi alterado.

 Um elétron de um átomo vizinho pode migrar para este átomo, cobrindo esta 'lacuna', de forma que agora o segundo átomo passa a apresentar uma 'lacuna'

• Podemos observar este movimento de lacunas como uma forma de corrente elétrica dada pelas cargas positivas em movimento

 Quanto maior a temperatura, mais ligações covalentes serão rompidas, portanto aumentando a capacidade de condução de corrente elétrica deste material.

• O aparecimento de pares de elétrons-livres e lacunas, obviamente em cargas iguais, se dá por um processo chamado de **geração térmica**.

• O contrário pode acontecer, de um elétron-livre voltar a ocupar uma lacuna que estava no material, num processo chamado de **recombinação**.

- A concentração de elétrons-livres (n) é semelhante à concentração de lacunas (p), de forma que $n=p=n_{\rm i}$
- Assim, n_i define o numero de elétrons-livres por cm³ de semicondutor intrínseco, e depende fortemente da temperatura:

$$n_i = BT^{3/2}e^{-E_g/2kT}$$

- B é uma constante do material (7,3*10¹⁵ cm⁻³K^{-3/2} para o silício)
- T a temperatura em Kelvin
- E_g a energia de bandgap, energia necessária para romper uma ligação covalente, liberando um par elétron-lacuna (1,12 eV para o silício)
- k a constante de Boltzmann (8,62*10⁻⁵ eV/K)

Semicondutores Extrínsecos

 Até então vimos uma estrutura cristalina de silício, que mesmo em temperatura ambiente possui uma quantidade muito pequena de pares de elétrons-livres e lacunas para conduzir uma quantidade relevante de corrente elétrica, além de ser fortemente dependente da temperatura, que é altamente indesejável

• Desejamos alterar, de forma substancial e precisamente controlada, a concentração de portadores no cristal de silício para aumentar a capacidade de condução de corrente.

• Isto é possível pelo processo de dopagem

Semicondutores Extrínsecos

• O processo de dopagem consiste da inserção de 'impurezas' no silício cristalino, introduzindo átomos de forma a aumentar a quantidade de elétrons-livres ou de lacunas no material, mas sem alterar a estrutura cristalina do silício.

• Introduzindo um átomo pentavalente, que possui 5 elétrons na camada de valência como o Fósforo, aumentamos a quantidade de elétrons-livres (n) no cristal, formando um material do **tipo n**

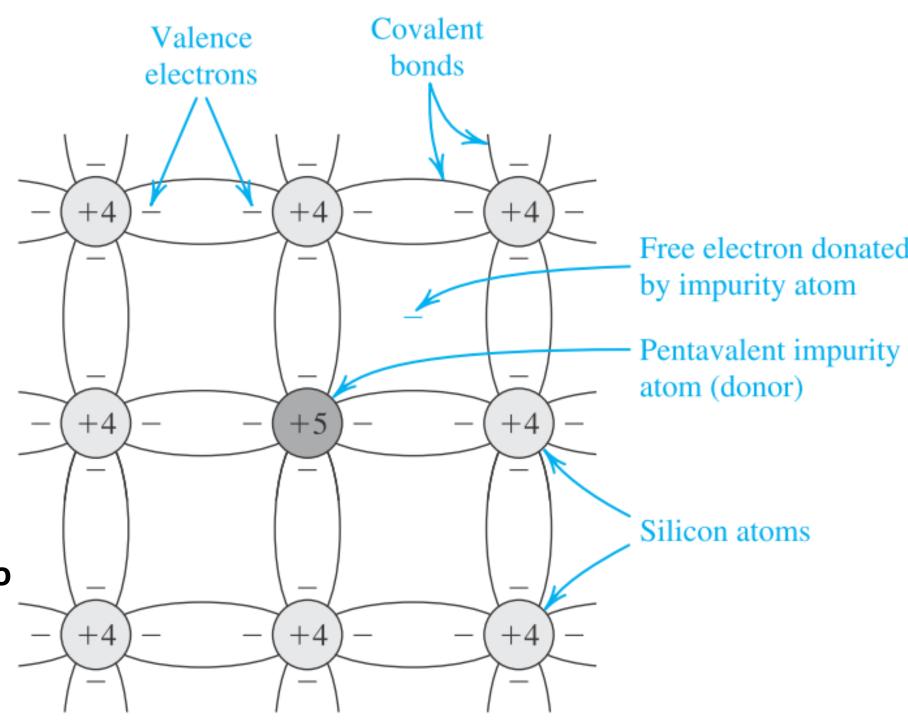
• Introduzindo um átomo trivalente, que possui 3 elétrons na camada de valência como o Bóro, aumentamos a quantidade de lacunas (p) no cristal, formando um material do **tipo p**

tipo n

 Prevalência de elétrons-livres no material

 A condução é dada majoritariamente pelo movimento de elétrons-livres

 O portador majoritário é o elétron-livre

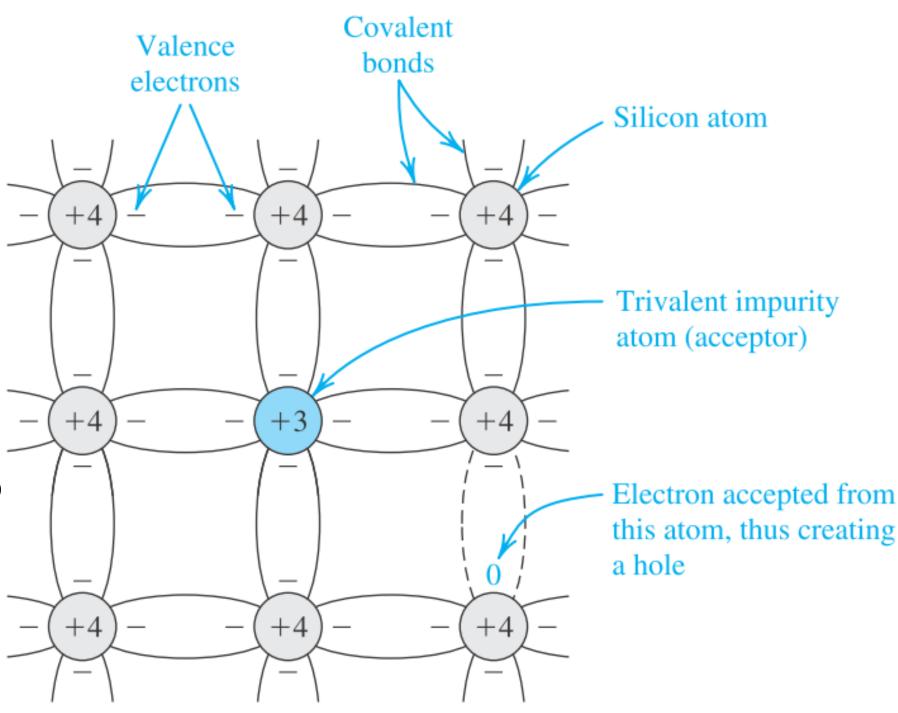


tipo p

 Prevalência de lacunas no material

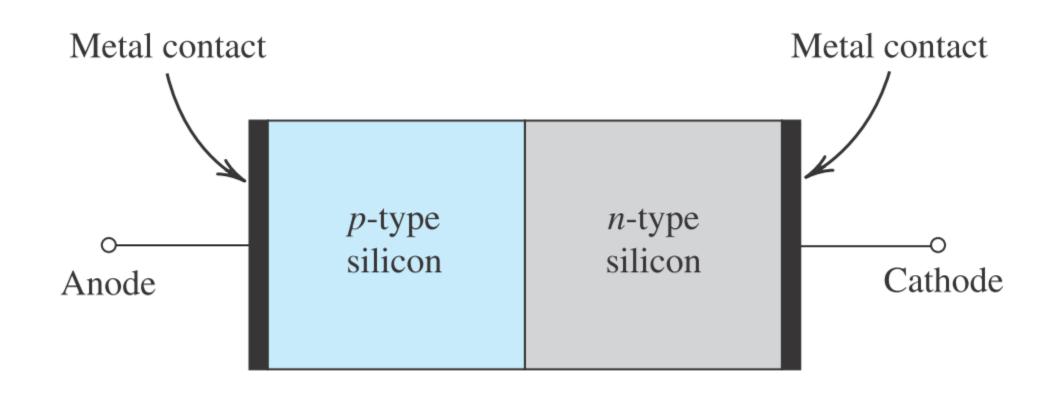
 A condução é dada majoritariamente pelo movimento de lacunas

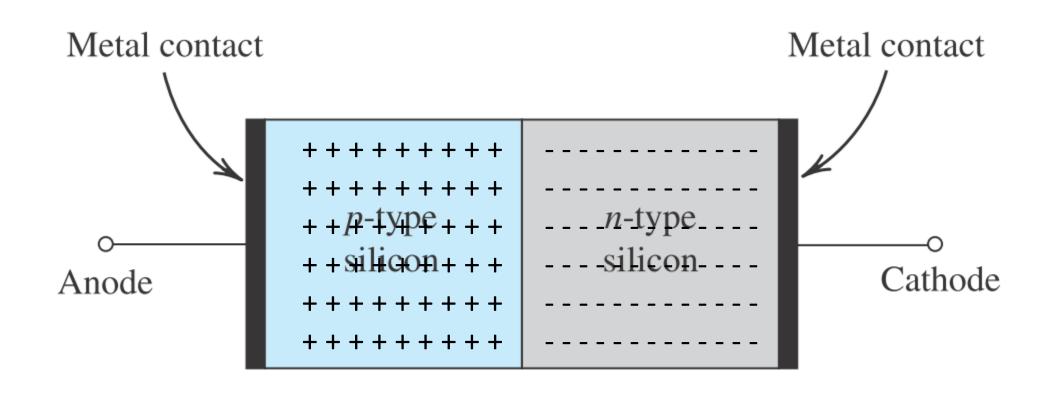
 O portador majoritário é a lacuna

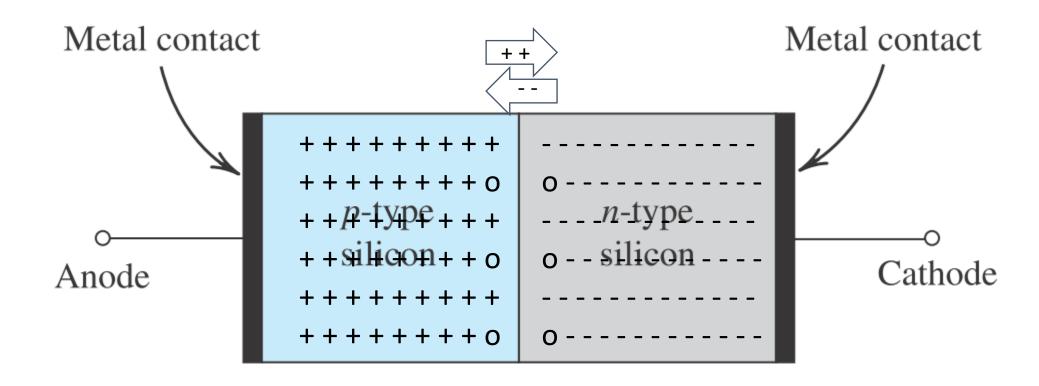


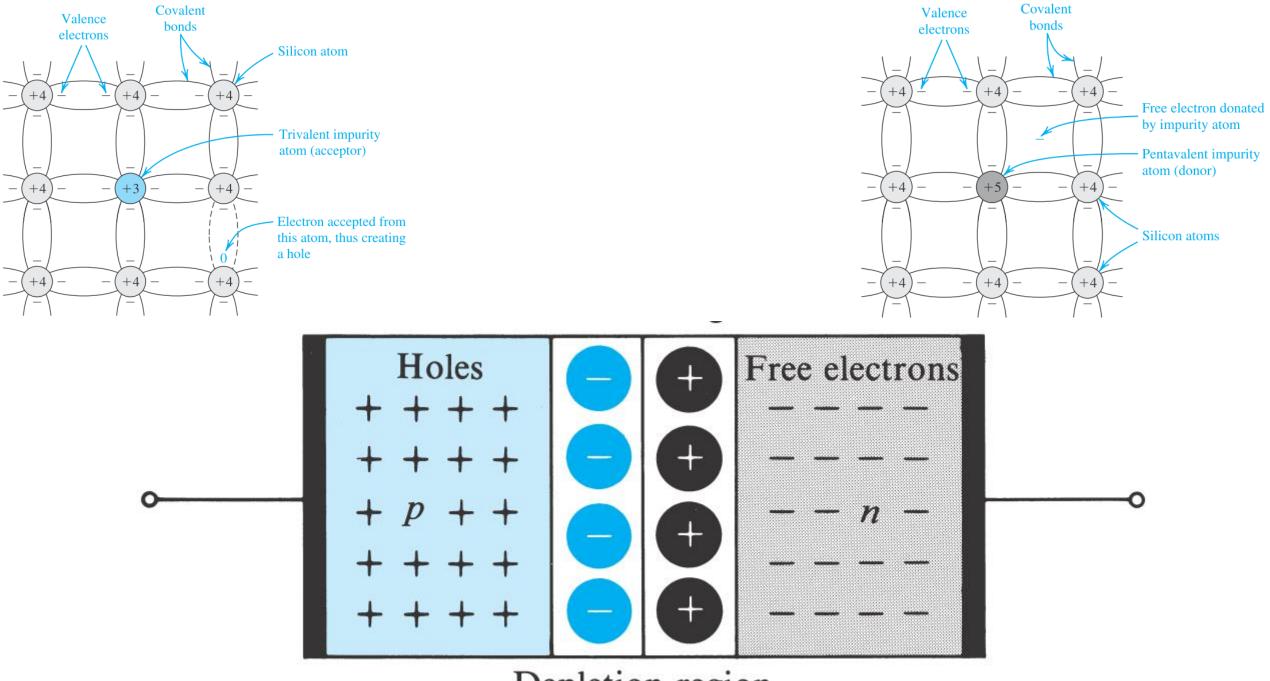
 Cada material, dos tipos p ou n, isoladamente, apesar de apresentarem características melhores de condução que o silício intrínseco, continuam matérias com pouca ou nenhuma utilidade prática

 A vantagem destes materiais provém da combinação deles, formando um dispositivo que apresenta uma junção semicondutora dos dois materiais.

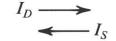




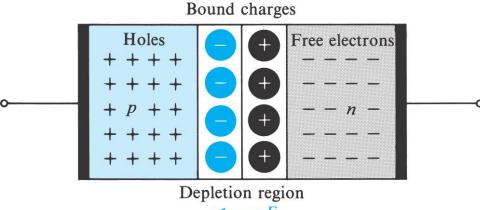




Depletion region

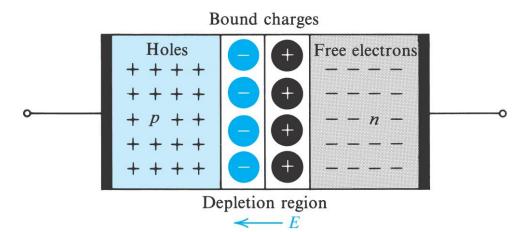


TI-1-



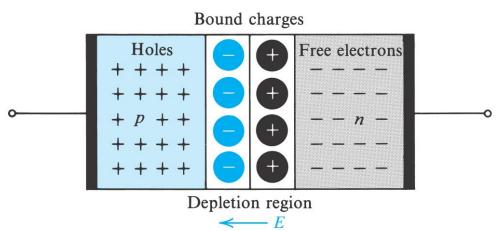
- Na região de interface, os elétrons livres do material tipo n são atraídos para o material do tipo p, da mesma forma, as lacunas do material tipo p são atraídas para o material do tipo n.
- Este processo é chamado de corrente de difusão, I_D
- Estes portadores que se difundiram pelos materiais se recombinam, formando uma região depletada de portadores





- Estes portadores que se difundiram pelos materiais se recombinam, formando uma região depletada de portadores.
- Estas cargas que se recombinaram passam a não mais equilibrar a carga dos átomos de origem, que então passam a apresentar um carga 'descoberta'
- No material tipo n surge uma região com carga positiva
- No material tipo p surge uma região com carga negativa
- Esta região é chamada região de depleção





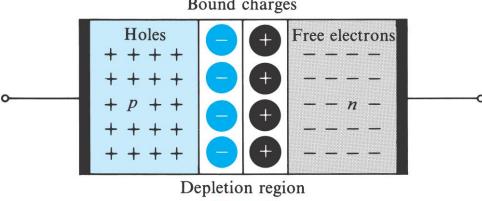
 Um campo elétrico E é induzido por essas cargas, com sinal positivo no material tipo n e sinal negativo no material tipo p

• Este campo elétrico passa a repelir os portadores livres nos materiais, impedindo a corrente de difusão e assim dificultando o 'transito' de portadores entre os materiais.

• Ainda assim, portadores minoritários, gerados termicamente, permitem uma pequena corrente de fuga I_S , a corrente de deriva

Bound charges

Junção PN



- · Com os terminais abertos, não há estímulos externos no material
- A tensão de barreira V_0 gerada pela região de depleção é dada por

com:

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

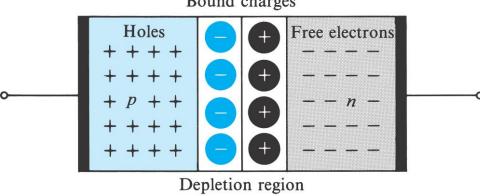
N_∆ a concentração de dopagem no material tipo n N_D a concentração de dopagem no material tipo p V_T a tensão térmica, 25mV em temperatura ambiente

No silício, V_0 fica entre 0,6 e 0,9V



Bound charges

Junção PN

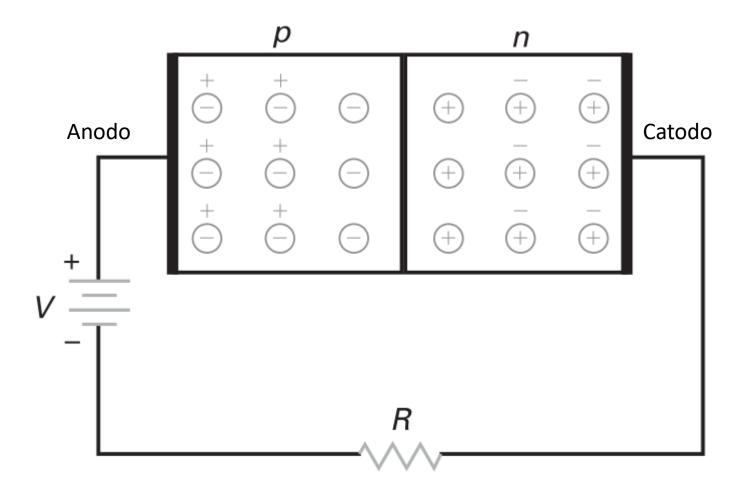


• É possível calcular a carga armazenada no material, mas não é relevante neste momento.

$$Q_J = A_V \sqrt{2\epsilon_s q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D}\right) V_0}$$

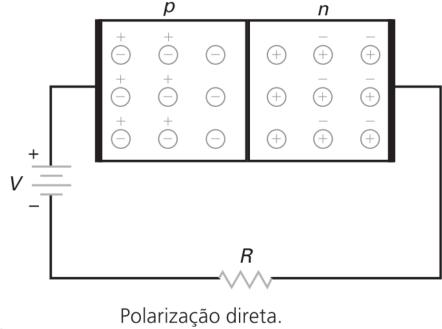
- ϵ_s a permissividade elétrica do material
- A a área da seção transversal da junção

Aplicando tensão entre os terminais



Polarização direta.

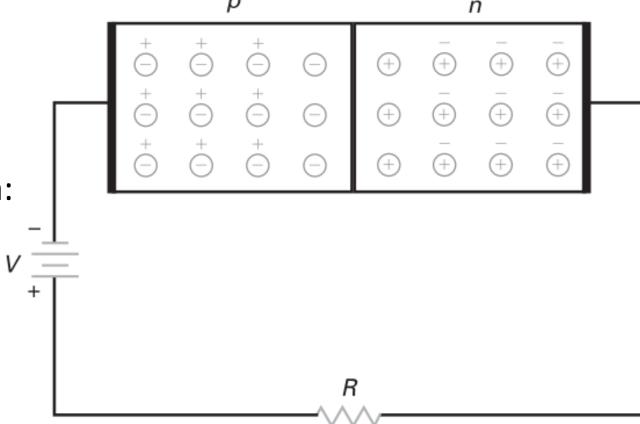
Polarização direta



- Com polarização direta, a fonte 'empurra' os elétrons livres contra a região de depleção.
- Com tensão na fonte menor que a tensão de barreira, os elétrons não conseguem ultrapassar a barreira e não há corrente
- Com tensão na fonte maior que a tensão de barreira, eles conseguem sobrepor a barreira e então o material permite a passagem de corrente elétrica

Polarização Reversa

• Com tensão aplicada de forma reversa:



Polarização reversa.

- A tensão da fonte acaba por intensificar a tensão de barreira, impedindo a passagem de elétrons.
- Nesta condição ainda haverá uma pequena corrente de fuga devido à geração térmica de portadores minoritários

Ruptura reversa

 Quando uma tensão muito alta é aplicada de forma reversa, pode ocorrer o rompimento do cristal semicondutor, inutilizando-o permanentemente, ou então outros efeitos que podem ser aproveitados para aplicações específicas.

• De maneira geral, para os dispositivos comuns, ultrapassando o limite de tensão reversa o material é permanentemente danificado

Revisão - Semicondutores

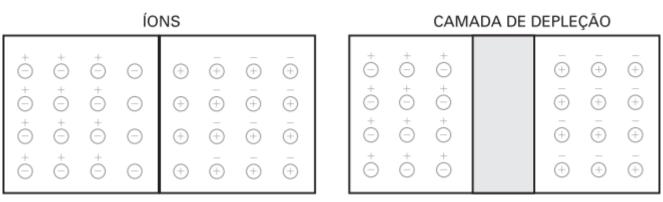
- Cristal intrínseco de silício:
 - formado por uma estrutura com apenas átomos de silício, onde cada átomo compartilha elétrons por meio de ligações covalentes, ficando química e eletricamente estável, formando um material 'isolante'.
- Com a energia térmica proveniente da temperatura ambiente, um elétron pode se desprender da camada de valência de se átomo original, tornandose um elétron-livre, e deixando no átomo uma lacuna na camada de valência.
- Um elétron-livre pode ocupar essa lacuna, o processo é chamado de recombinação.
- Esse movimento de elétrons-livres e lacunas são um caminho de corrente, portanto o silício puro é um isolante ruim.

Revisão - Semicondutores

- Dopagem
 - Processo para aumentar a condutividade do cristal semicondutor
- Um semicondutor dopado é chamado de semicondutor extrínseco
- Acréscimo de impureza pentavalente (átomo doador) resulta em um elétron-livre em excesso (arsênico, antimônio e fósforo)
 - Material tipo n
 - Neste material, os elétrons livres são os portadores majoritários e as lacunas portadores minoritários.
- Acréscimo de impureza trivalente (átomo aceitador) resulta em uma lacuna em excesso (alumínio, boro e gálio)
 - Material tipo p
 - Neste material, as lacunas são os portadores majoritários e os elétrons livres portadores minoritários.

Revisão - Semicondutores

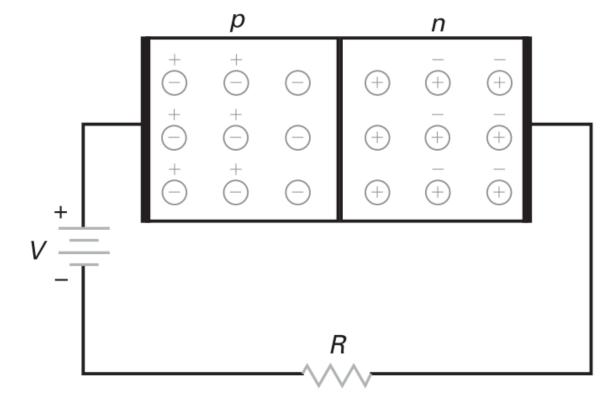
- Junção pn
- Em um cristal com metade do material do tipo n e metade do tipo p, a interface entre os materiais forma a junção pn, nesta região se forma a camada de depleção devido ao processo de recombinação dos portadores.



o campo elétrico entre os íons é equivalente a uma diferença de potencial chamada de barreira de potencial

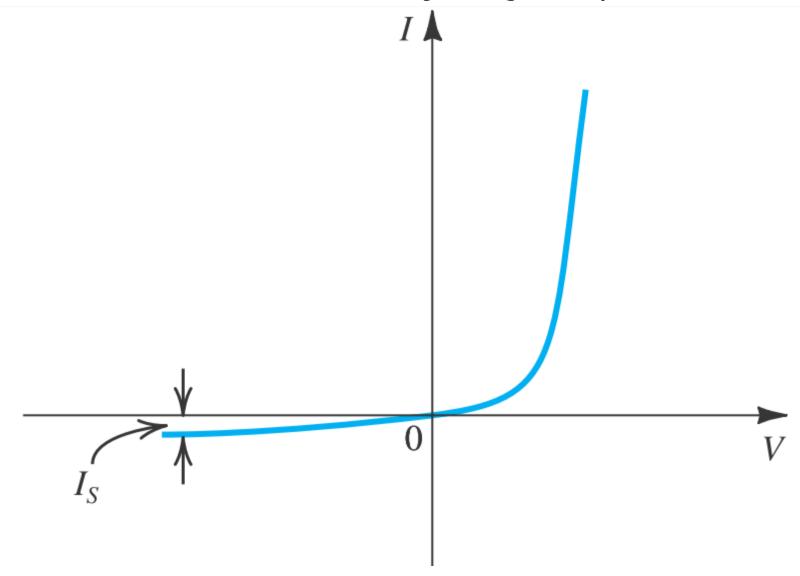
Semicondutores – Diodo junção de dois eletrodos

 A barreira de potencial na camada de depleção na região de junção dos materiais tipo n e tipo p interage com o fluxo de portadores quando o material é polarizado entre dois terminais



REVER CAPÍTULO 2 Malvino Eletrônica 1 Seções 2-9 a 2-14

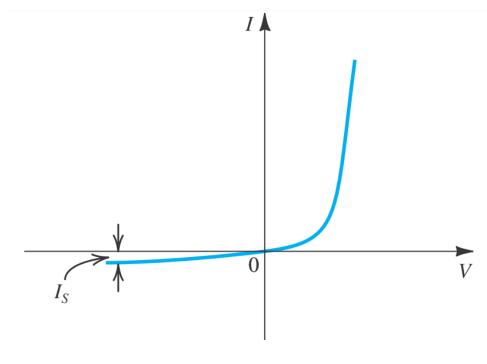
Aplicando tensão numa junção pn



Aplicando tensão numa junção pn

• Este comportamento não linear de relação tensão –corrente dá origem ao mais simples componente semicondutor, o **DIODO**

 O diodo tem por característica permitir passagem de corrente em apenas um sentido



Diodos

Resistor – Dispositivo linear

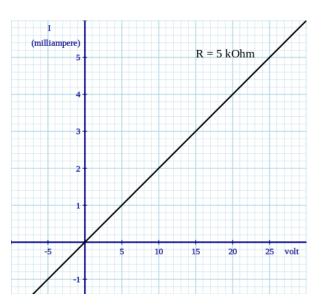


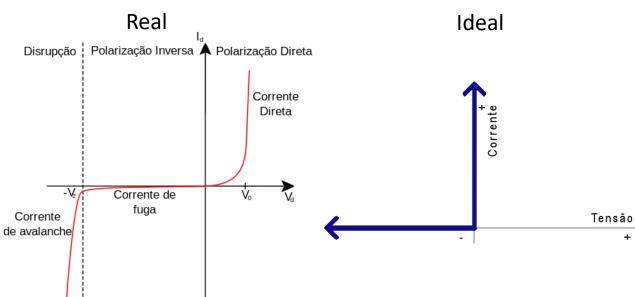
• Diodo – Dispositivo não-linear





Real/Ideal

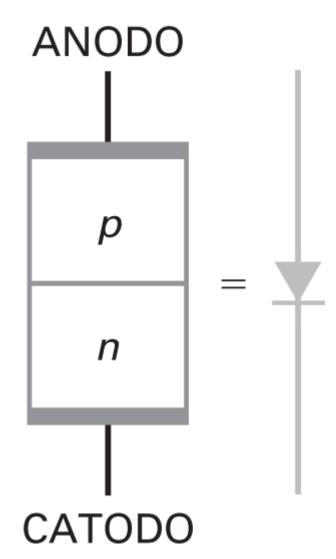




Diodo de junção – Conceitos básicos

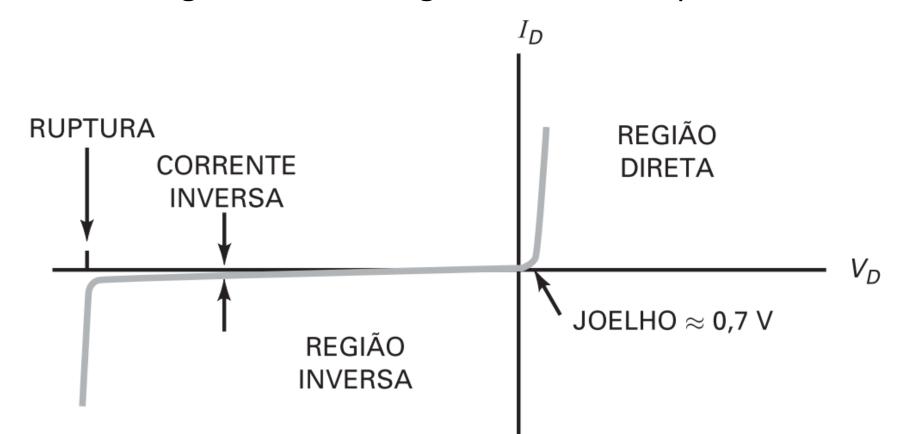
 O diodo é um elemento de circuito que permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido

- Quando polarizado diretamente → Permite
 - Ideal: curto-circuito
- Quando polarizado reversamente → Bloqueia
 - Ideal: circuito aberto

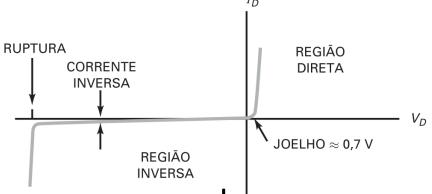


Diodo – curva de operação

O comportamento real do diodo apresenta três regiões distintas:
 Região Direta – Região Reversa - Ruptura



Região Direta



- Quando polarizado diretamente o diodo permite a passagem del corrente, a partir da tensão suficiente para vencer a barreira na junção.
- Este potencial é chamado de **tensão de joelho**, em referencia à forma que a curva se dobra neste ponto
- Em diodos de silício esta tensão é aproximadamente 0,7V
- A corrente aumenta com uma razão exponencial, sendo limitada pelo comportamento da junção semicondutora
- Por simplicidade este comportamento pode ser aproximado ao de uma resistência

Região Reversa/Inversa e Ruptura

 Quando polarizado reversamente o diodo bloqueia a passagem de corrente

• Quando a tensão reversa excede o limite de projeto o diodo entra em ruptura e pode ser destruído

MAXIMUM RATINGS (T _A = 25 °C unless otherwise noted)										
SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT		
V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V		
V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V		
V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V		
I _{F(AV)}	1.0						Α			
	V _{RRM} V _{RMS} V _{DC}	SYMBOL 1N4001 V _{RRM} 50 V _{RMS} 35 V _{DC} 50	SYMBOL 1N4001 1N4002 V _{RRM} 50 100 V _{RMS} 35 70 V _{DC} 50 100	SYMBOL 1N4001 1N4002 1N4003 V _{RRM} 50 100 200 V _{RMS} 35 70 140 V _{DC} 50 100 200	SYMBOL 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 V _{RRM} 50 100 200 400 V _{RMS} 35 70 140 280 V _{DC} 50 100 200 400	SYMBOL 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 V _{RRM} 50 100 200 400 600 V _{RMS} 35 70 140 280 420 V _{DC} 50 100 200 400 600	SYMBOL 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 V _{RRM} 50 100 200 400 600 800 V _{RMS} 35 70 140 280 420 560 V _{DC} 50 100 200 400 600 800	SYMBOL 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 V _{RRM} 50 100 200 400 600 800 1000 V _{RMS} 35 70 140 280 420 560 700 V _{DC} 50 100 200 400 600 800 1000		

Potência em um diodo

- A potencia dissipada por um diodo é o produto tensão x corrente sobre ele
- O calor gerado pode destruir o cristal semicondutor
- Os datasheets dos componentes trazem o valor de corrente máxima ou potência máxima suportada

MAXIMUM RATINGS (T _A = 25 °C unless otherwise noted)										
PARAMETER	SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT	
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V	
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V	
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V	
Maximum average forward rectified current 0.375" (9.5 mm) lead length at T _A = 75 °C	I _{F(AV)}	1.0						Α		